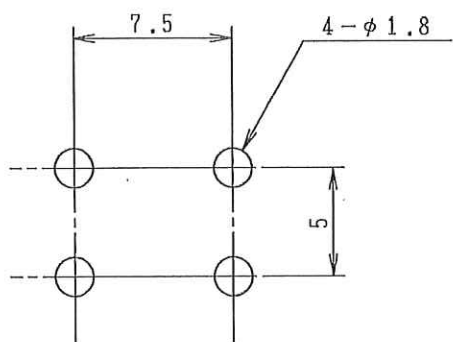
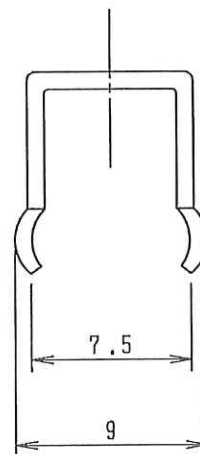
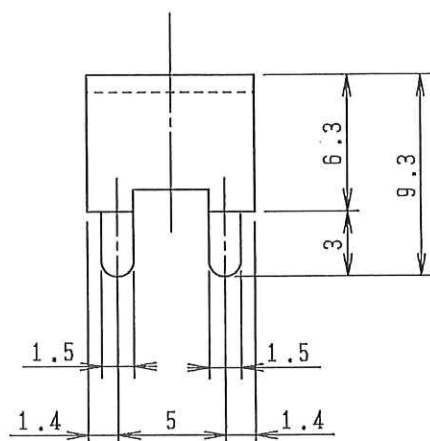
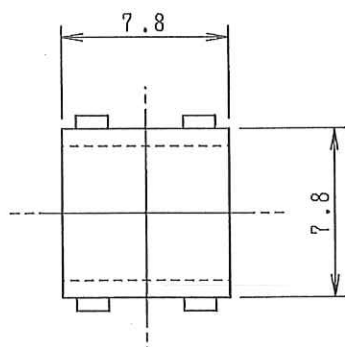


1
2
3
4
5

部番	名 称	材 質	寸 法	処 理	備 考
1	基板端子	C2680P	t=0.8	Ep-Cu/Cu3 μ mUP+Ni3 μ mUP, Sn3 μ mUP	
2					
3					
4					
5					

工場管理部



基板加工例

- ※1. 鉛フリー対応の為、表面処理変更。
 ※2. 梱包箱の品名ラベルに「RoHS Compliance」と表示すること。
 ※3. 基板端子は、ハンダメッキの在庫がなくなり次第
 鉛フリー品②及び③に変更すること。
 (メッキ仕様②の在庫が無くなり次第③に切り替えとする。
 但し、②のメッキ変更品がない場合は、①より③へ切り替えとする。)



番号	メッキ仕様変更内容
①	ハンダメッキ : Ep-Cu/Cu2, Sn(90)-Pb3
②	鉛フリー : Ep-Cu/Cu3 μ mUP+Ni1 μ mUP, Sn3 μ mUP
③	鉛フリー : Ep-Cu/Cu3 μ mUP+Ni3 μ mUP, Sn3 μ mUP

改 定				指示なき公差	定 格	AC	V	15	A	図 番	107001-3				設計		
	$\triangle_3^2$	07.7.23	メッキ厚訂正、 鉛フリー表変更 池田	±0.2	絶縁抵抗	DC	V	MΩ以上			国 名	FP-423-7001			製図	池田	04.9.30
	$\triangle_2^2$	04.10.26	メッキ表示訂正 池田			検図	下松				04.10.1						
	$\triangle_3^1$	04.9.30	図面書換え 池田 鉛フリーに変更		耐電圧	AC	V	 フジコン株式会社			三角法	単位	mm	尺度	$\frac{3}{1}$	承認	神山
記号	日付	内 容	1分間異常なし														